



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板引导硬件



背板引导硬件类型: 导针

背板引导位置: 背板

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

背板引导硬件类型	导针
----------	----

结构特性

背板引导位置	背板
--------	----

主体特性

导轨元件电镀材料表面涂层	亮光
导轨元件电镀材料	银
导轨元件基材	锌合金

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

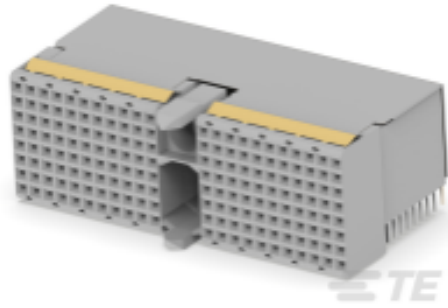
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1766876-1
PLATED CONTACT,SKT BOD

客户还购买了



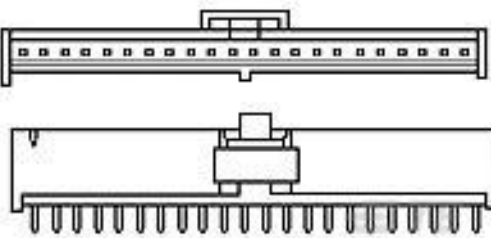
TE 产品编号3-646486-0
8-ROW,TWST,TUL TYPE/D W/SHEILD



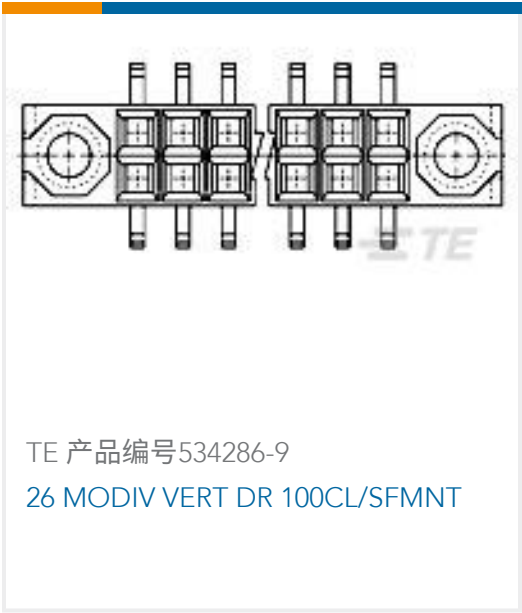
TE 产品编号3-5331272-9
SOCKET,MIN-SPR W/H SN-AU SER-2



TE 产品编号YDTS20F25-04SDV001
RECP ASSY



TE 产品编号3-1888291-3
FPH-2021G=FLXPAC HDR P 20 ST L



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1410955-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1410955-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1410955-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本